

# おおいたLSIクラスターの活動事例

## 研究開発

### テスト・評価技術分野

- テスターバーンイン研究WG (ワーキンググループ)**  
LSIテスト装置の開発に必要な安定した高信頼性コンタクト技術を確立する研究開発
- バーンイン装置におけるチャンパー性能の研究WG**  
小型で生産量に見合う多品種少量型バーンイン装置開発
- テスター研究WG**  
計測器と組み合わせることにより低価格を実現した高速信号テスト処理装置
- ALPG研究WG**  
小型かつ低価格な高速パターンジェネレータ回路の研究開発
- 高速ミクストシグナル簡易テスト開発WG**  
小型で低価格の高速ミクストシグナル簡易テスト開発



バーンイン装置におけるチャンパー性能の研究 (小型チャンパー)



テスター研究



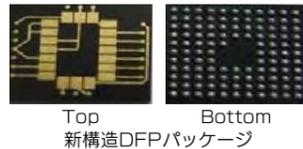
ICソケットのコンタクト部洗浄

### 装置部品洗浄技術分野

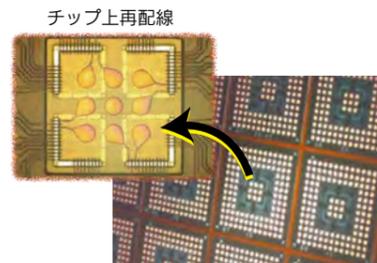
- CO<sub>2</sub>洗浄機でのバーンインボード洗浄システムの開発WG**  
CO<sub>2</sub>洗浄機によるバーンインボードの洗浄技術の確立

### 実装技術分野 (新パッケージ技術)

- Fan-Out型WLP用パネルスケールLow cost再配線技術開発WG**  
パネルスケールでのFan-Out配線・パッド接続一括プロセス適用によるパッケージ用低コスト再配線プロセスの開発
- 携帯電話用の新構造DFPパッケージ開発WG**  
薄型化、低コストを目指した新構造DFPパッケージ開発



Top Bottom  
新構造DFPパッケージ

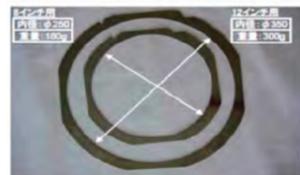


チップ上再配線

パネル外観 (個片化前)

### 装置部品技術分野

- 12インチ軽量ウエーハリングの開発WG**  
重量を60%軽減した12インチウエーハリングの開発
- プラスチックウエーハリング開発WG**  
軽量かつ強靱で安価な8インチ用高剛性プラスチックウエーハリングの開発



ウエーハング



エクステンジャー装置

### 装置化技術分野

- エクステンジャー開発WG**  
Final Test用ソケットのプローブピンの交換を自動且つ、高速で交換できる装置の開発

## 人材育成

### 半導体基礎講座の開催

新入社員・事務部門・間接部門の方々等を対象に半導体基礎講座を開催する。

### 技術者研修会の開催

半導体関連技術者を対象に、パワーデバイス、MEMS、メディカル等今後、成長が見込まれる技術分野への新たな参入を目的とした、体系的な技術研修会を開催する。

### 海外展開に向けたスキルアップ研修会の開催

台湾、韓国等東アジアとの取引拡大に向けたビジネススキルアップ研修会を開催する。

2012.6.28-29  
台湾・中国ビジネススキルアップ研修



パワーデバイスセミナー (3回シリーズ)



## 販路開拓・情報提供

### ニーズ・シーズの調査、展示会等ビジネスマッチングの支援

- ニーズ・シーズの調査によるビジネスマッチング**  
県内外の大手半導体関連企業等を訪問し、ニーズやシーズを調査し、クラスター会員とのビジネスマッチングを迅速に行うことで、取引の拡大を目指す。
- 展示会への出展**  
世界最大の半導体装置・材料の国際展示会であるセミコン・ジャパン等に出展する。大分県内企業を広くPRするとともに、研究開発の成果物等も紹介する。



2012.12.5-7 セミコンジャパン

### 台湾・韓国とのビジネス交流

台湾電子設備協会との相互交流に向けた覚書の締結によるビジネス交流を促進するとともに、韓国・悟倉(オチャン)半導体クラスターや韓国産業団地公団(KICOX)とのビジネス交流を継続する。



2012.5.11  
台湾企業との商談会 (大分)



2012.12.3  
商談成立調印式

## 会員交流

### トップセミナーの開催

国内外経営トップ相互の交流会を開催する。

### 交流会の開催

- 技術者交流会の開催**  
会員企業の技術者を対象に交流会を開催する。
- その他の交流活動**  
他地域のクラスターや海外と交流を行い、ネットワークを形成する。



2012.9.14 トップセミナー